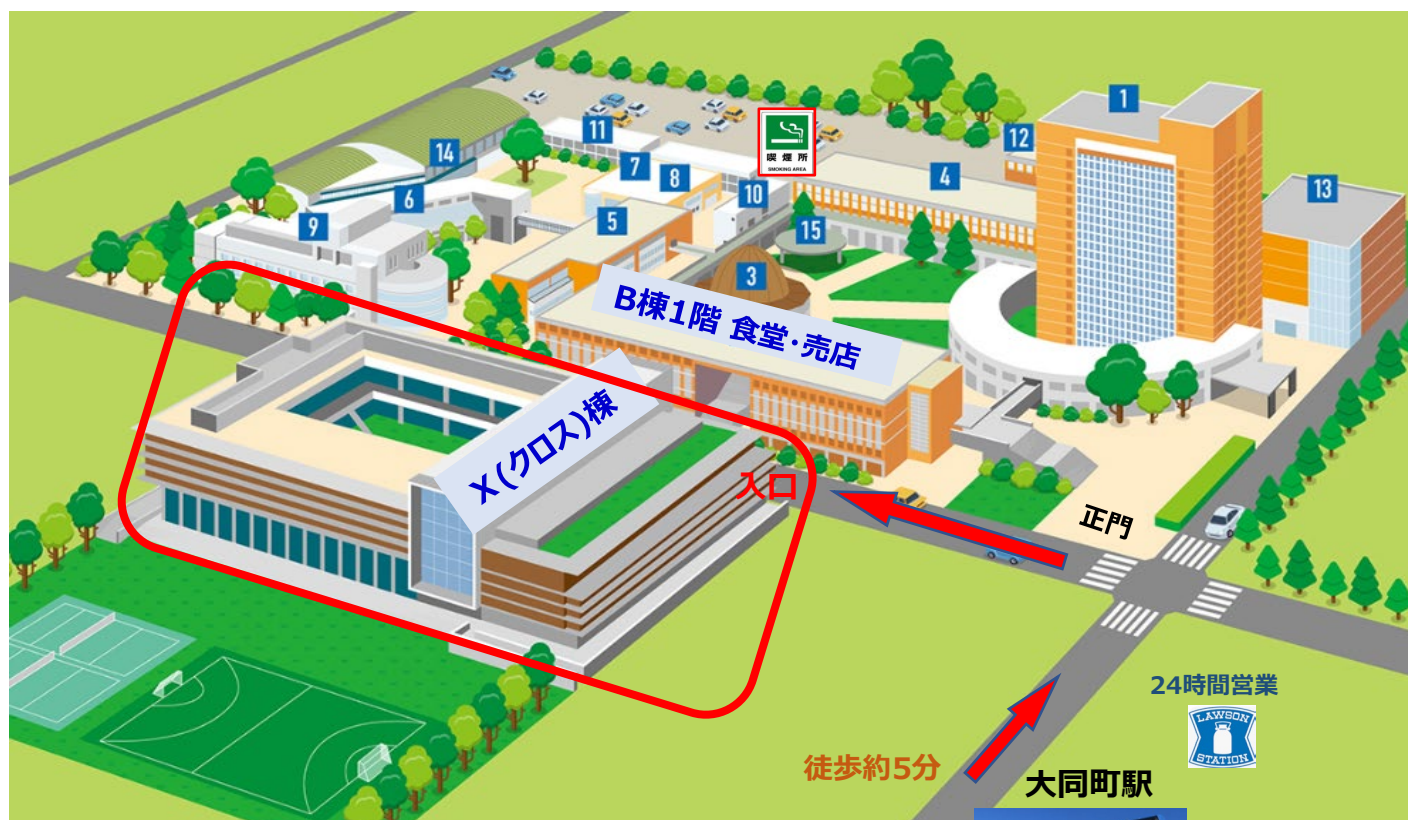




MES開催会場と食堂・売店以外は**立ち入り禁止**です

講義室での**食事は禁止**です

B棟1F 売店 営業時間：9:00～14:00

B棟1F 食堂 営業時間：11:30～13:30

所定場所以外での**喫煙は禁止**です

手荷物等は、ご自身にて管理ください



SSID: daido-cf

PASS: Daido8530#

電源は、講義室の机にあります

| MES2023 プログラム（特別セッション） |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9月6日(水) 開始時間 13:00     |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 会場                     | A会場 (X0202講義室)                                                                          | B会場 (X0203講義室)                                                                                                                             | C会場 (X0204講義室)                                                                                                                             |
| セッション                  | パワーエレクトロニクス実装特別セッション<br>～電動モビリティを日本のパワーエレクトロニクス技術で進めるために～                               | ロードマップセッション                                                                                                                                | 第44回電子デバイス実装研究委員会<br>「エレクトロニクス業界と環境問題」                                                                                                     |
| 13:00                  | 趣旨説明                                                                                    | 【依頼】光回路実装(OPT) 13:00-13:50 50分<br>「100Tbs超スループットの実現に向けた光回路実装形態の予測と課題」<br>株式会社白山<br>竹崎元人<br>6B1-1                                           | 【依頼】5件<br>(主催: スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会)<br>13:00-13:40 40分<br>「資源循環促進のための物理選別技術<br>～電子素子選別を発端とした選別装置自律制御化～」<br>産業技術総合研究所<br>大木達也<br>6C1-1 |
|                        | 【依頼①】13:05-14:05 60分<br>「成長を続けるSiC/GaNパワー半導体」<br>株式会社産業タイムズ社<br>津村明宏<br>6A1-1           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|                        | 【依頼②】14:05-14:55 50分<br>「SiC普及に向けた取り組みと2100年のモビリティ」<br>一般社団法人SiCアライアンス<br>戸田敬二<br>6A1-2 | 【依頼】部品内蔵 13:50-14:40 50分<br>「部品内蔵技術ロードマップ2022年度版概要」<br>株式会社図研<br>松澤浩彦<br>6B1-2                                                             | 13:40-14:20 40分<br>「PFAS規制に対するJEITA半導体の活動」<br>ヌヴォンテクノロジージャパン株式会社<br>吉田浩芳<br>6C1-2                                                          |
|                        | 14:55-15:10 休憩 15分                                                                      | 14:40-15:00 休憩 20分                                                                                                                         | 14:20-14:30 休憩 10分                                                                                                                         |
|                        | 【依頼③】15:10-16:00 50分<br>「GaNパワーデバイスの研究開発動向と実装技術への期待」<br>名古屋大学<br>加地徹<br>6A1-3           | 【依頼】JEITA実装 15:00-15:50 50分<br>「注目される市場と電子機器群」<br>～ 脱コロナ・脱炭素を加速する新市場 ～<br>三菱電機株式会社<br>西村隆<br>6B1-3                                         | 14:30-15:10 40分<br>「Bi系高温鉛フリーはんだ材料の開発と実用化」<br>広島大学大学院<br>末次憲一郎<br>6C1-3                                                                    |
|                        | 【依頼④】16:00-16:50 50分<br>「KAMOME PJ の12年の成果と新しい展開」<br>元 横浜国立大学・KAMOME<br>高橋昭雄<br>6A1-4   | 【依頼】JEITA実装 15:50-16:40 50分<br>JEITA2022年度版実装技術ロードマップ(1)<br>「CPS (Cyber-Physical System) に向けて加速する電子デバイスパッケージ」<br>ナミクス株式会社<br>尾崎裕司<br>6B1-4 | 15:10-15:50 40分<br>「MILATERA SnBi低温ソルダリングソリューション」<br>千住金属工業株式会社<br>北沢和哉<br>6C1-4                                                           |
| 17:45                  | 【依頼⑤】16:50-17:40 50分<br>「e-Mobility インバータ生産における最新技術の動向」<br>株式会社デンソー<br>福西篤志<br>6A1-5    |                                                                                                                                            | 15:50-16:00 休憩 10分                                                                                                                         |
|                        | セッションクローズ                                                                               |                                                                                                                                            | 16:00-16:40 40分<br>「カーボンナノチューブ系導電性ペーストにおける動的パーコレーション現象の解析」<br>群馬大学大学院<br>井上雅博<br>6C1-5                                                     |

論文閲覧 Zoom視聴 QRコード

(ID・PWは、5 日午前、参加登録者に送信)

HP⇒MES2023⇒プログラム⇒Zoom・論文PDF



【大同大学 X棟(クロス棟) 2階 MES2023会場レイアウト】



三井化学株式会社

【スポンサー】

奥野製薬工業株式会社



ウシオ電機株式会社



オムロン株式会社





| MES2023 プログラム (一般講演・企業セッション・表彰式・特別講演) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9月7日(木) 開始時間 10：00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 会場                                    | A会場 (X0202講義室)                                                                                                                                                                                                                                                                            | B会場 (X0203講義室)                                                                                                                                                 | C会場 (X0204講義室)                                                          | D会場 (X0205講義室)                                                                          |
| セッション                                 | インテリジェント実装技術                                                                                                                                                                                                                                                                              | マイクロメカトロニクス実装技術                                                                                                                                                | めっき技術                                                                   | 企業展示セッション (発表)                                                                          |
| 10:00                                 | 【依頼】<br>「ニューラルネットワークのウェハスケール集積回路実装」<br>～欠陥や故障があっても動作する AI ハードウェア～<br>筑波大学<br>安永守利<br><br>7A1-1                                                                                                                                                                                            | 【依頼】<br>「宇宙向けMEMS小型冗長慣性センサMRN-01の開発」<br>住友精密工業株式会社<br>堂山英之<br><br>7B1-1                                                                                        | 【依頼】<br>「三次元実装TSV応用に向けた無電解めっきによるバリア膜の形成」<br>関西大学<br>新宮原正三<br><br>7C1-1  | ---                                                                                     |
| 10:20                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 10:40                                 | 「インテグレーションニューラルネットワーク近似器の適正学習率の効果」<br>大阪大学<br>岩田剛治<br>7A1-2 (0041)                                                                                                                                                                                                                        | 「CuO/Ag積層焼成接合体の熱機械信頼性とき裂進展メカニズム」<br>京都先端科学大学<br>生津資大<br>7B1-2 (0017)                                                                                           | 「回折光学素子用金型製造プロセスにおけるNi電鍍の欠陥低減と剥離法の検討」<br>大阪公立大学<br>満畑凌生<br>7C1-2 (0063) | 「使用環境での材料の振る舞いを知る—温度コントロール下での材料分析—」<br>ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社<br>川田友紀<br>7D1-1 (0043) |
| 11:00                                 | 休憩(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                         | 「SAP・インターポーザ向け硫酸銅めっきおよびエッチングプロセスの開発」<br>株式会社JCU<br>鈴木陽平<br>7D1-2 (0019)                 |
| 11:20                                 | 「直接イオン化質量分析と機械学習によるシリコン放熱材料の性能予測評価」<br>株式会社日立製作所<br>露木康博<br>7A1-3 (0056)                                                                                                                                                                                                                  | 「A NEW TECHNIQUE FOR IMPROVING MECHANICAL RELIABILITY OF SILICON MEMS USING ELECTRON BEAM INDUCED SILICON NANODOTS」<br>京都先端科学大学 Abbhiraj Singh<br>7B1-3 (0022) | 「粒状銅めっき皮膜が封止樹脂との密着性に与える影響」<br>奥野製薬工業株式会社<br>中亮太<br>7C1-3 (0004)         | 「アルミニウム電極上に厚膜形成可能な中性無電解銅めっき液」<br>メルテックス株式会社<br>長島末希<br>7D1-3 (0042)                     |
| 11:40                                 | 「動物園来場者に向けたリアルタイム認識システムの提案」<br>長野工業高等専門学校<br>下平佳乃音<br>7A1-4 (0076)                                                                                                                                                                                                                        | 「Agメタライゼーション層を用いた3次元集積化用低温・低圧Cuバンプ接合方法」<br>大阪大学<br>張 政<br>7B1-4 (0075)                                                                                         | 「無電解めっきバリア上への直接電解CuめっきによるTSV形成技術」<br>関西大学<br>陳少韓<br>7C1-4 (0011)        | 「難めっき材へも高密着 めっきプライマー塗料「メタロイド」」<br>株式会社イオックス<br>中澤悠人<br>7D1-4 (0044)                     |
| 12:00                                 | 「ぶどう園における鳥認識精度に関する研究」<br>長野工業高等専門学校<br>萩原奏良<br>7A1-5 (0078)                                                                                                                                                                                                                               | 「マイクロLEDディスプレイ製造における歩留まり改善に向けた取り組み」<br>東レエンジニアリング株式会社<br>梅田英知<br>7B1-5 (0005)                                                                                  | 「銅めっきの均一電着性技術の向上」<br>大阪公立大学<br>前川育穂<br>7C1-5 (0048)                     | 「密着性向上効果のあるゾルゲル処理剤」<br>ハニー化成株式会社<br>臼井寛明<br>7D1-5 (0013)                                |
| 12:20                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
|                                       | 昼食 12:20～13:20 (60分)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 13:20                                 | 企業展示コアセッション(60分) X棟 展示スペース<br>①奥野製薬工業株式会社 (0051) ②ライブサイエンス (0058) ③メルテックス株式会社 (0042) ④株式会社イオックス (0044)<br>⑤ハニー化成株式会社 (0013) ⑥石川金属株式会社 (0070) ⑦株式会社JCU (0019) ⑧ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社 (0043)<br>⑨ノードソン株式会社 (0081) ⑩日邦産業株式会社 (0082) ⑪株式会社サーモグラフィクス (0083) ⑫株式会社日立ハイテック (0084)<br>7E1-1～12 |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 14:20                                 | 休憩(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 14:30                                 | 表彰式 A会場<br>ベストペーパー賞：5件、研究奨励賞：5件                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 15:00                                 | 休憩(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 15:10                                 | 特別講演 A会場 7E2-1<br>「工学系の女性研究者として」<br>大同大学 大同学園 顧問 前学長<br>神保睦子                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 16:10                                 | 休憩(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 16:20                                 | 特別講演 A会場 7E2-2<br>「将来の高性能コンピュータを実現するAMDの最先端実装技術」<br>日本AMD株式会社 代表取締役<br>関路子                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 17:20                                 | 移動(55分)<br>各自                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 18:15                                 | 交流会 事前申し込みが必要です<br>ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 2階 カジュアルダイニングガーデンコート (金山駅)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |
| 19:45                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                         |

【交流会会場マップ】 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 2階 カジュアルダイニング「ガーデンコート」



金山駅南口より徒歩1分（美術館入口より連絡通路あり）



| MES2023プログラム（一般講演）  |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9月8日(金) 開始時間 9：30   |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 会場                  | A会場（X0202講義室）                                                                                | B会場（X0203講義室）                                                                       | C会場（X0204講義室）                                                                           | D会場（X0205講義室）                                                                                                                                                    |
| セッション               | 高速高周波実装技術・電磁特性技術                                                                             | パワーエレクトロニクス実装技術-1                                                                   | フレキシブル・ウェアラブルエレクトロニクス                                                                   | 信頼性技術-1                                                                                                                                                          |
| 9:30                | 「メタマテリアルを利用した低姿勢広帯域円偏波パッチアンテナ」<br>東京工芸大大学院<br>伊佐山貞治<br>8A1-1（0069）                           | 【依頼】<br>「次世代モビリティ向けパワーモジュールに期待される実装技術」<br>株式会社ミライステクノロジーズ<br>岩重朝仁<br><br>8B1-1      | 「層状炭素材料を用いた柔軟かい圧力センサの開発」<br>山形大学<br>関根智仁<br><br>8C1-1（0049）                             | 「ウエハ接合強度の長期負荷及び測定環境の影響」<br>横浜国立大学<br>佐野麻理恵<br><br>8D1-1（0020）                                                                                                    |
| 9:50                | 「パッチアンテナ表面の湾曲化による放射特性の広角化の検討」<br>東京工芸大大学院<br>佐々木由紀<br>8A1-2（0068）                            |                                                                                     | 「スクリーン印刷を用いたFHE無線通信回路の開発」<br>山形大学<br>吉田綾子<br><br>8C1-2（0050）                            | 「アナログ素子のみで構成する弛緩発振器によるIC間抵抗断線の検出可能性調査」<br>徳島大学<br>大松正男<br>8D1-2（0012）                                                                                            |
| 10:10               | 「人体近傍に配置されたアンテナが人体周囲につくる電磁界分布と伝送特性の検討」<br>東京工芸大大学院<br>品川陽斗<br>8A1-3（0065）                    | 「高Tgモールド樹脂を適用した高耐熱パワーモジュールパッケージの検討」<br>三菱電機株式会社<br>西原孝太郎<br>8B1-2（0047）             | 「ストレッチャブル印刷配線の真空成形中における伸張変形による配線抵抗変化の解析」<br>群馬大学大学院<br>大嶋玲奈<br>8C1-3（0072）              | 「フレキシブル銀ナノワイヤネットワーク配線のエレクトロマイグレーション損傷」<br>弘前大学<br>相馬佑亮<br>8D1-3（0053）                                                                                            |
| 10:30               | 休憩(20分)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 10:50               | 「スパイラルコイルを利用した経皮情報伝送における電磁界分布の検討」<br>東京工芸大大学院<br>市川達大<br>8A1-4（0064）                         | 「パワー半導体向け封止樹脂の高耐熱化に向けた樹脂設計検討」<br>サンエック株式会社<br>安藤和哉<br>8B1-3（0030）                   | 「ウェアデバイス開発のためのニットセンサの作製条件による特性比較」<br>産業技術総合研究所<br>泉小波<br>8C1-4（0001）                    | 「はんだ付け性試験の濡れ性挙動に基づく新規前処理の検討」<br>TDK株式会社<br>泉水崇彰<br>8D1-4（0006）                                                                                                   |
| 11:10               | 「スピルリナを鋳型とした銅マイクロコイルによるテラヘルツ電磁応答」<br>奥野製薬株式会社<br>有清恵太<br>8A1-5（0040）                         | 「ZnAl共析合金を用いた拡散接合プロセスと接合部の疲労特性の研究」<br>鹿児島大学<br>倉員友希<br>8B1-4（0034）                  | 「マイクロパワー有機回路を搭載したシート型印刷センサ」<br>大阪大学大学院<br>秋山実邦子<br>8C1-5（0016）                          | 「放射光X線回折による平板状試料内部におけるはんだの非破壊信頼性評価技術」<br>理化学研究所<br>林雄二郎<br>8D1-5（0077）                                                                                           |
| 11:30               | 「材料の損失を考慮した周期構造を有する伝送線路によるクロストーク抑制技術のインターポーザへの適用検討」<br>日本アイ・ビー・エム株式会社<br>大島大輔<br>8A1-6（0062） | 「故障個所の予測に向けたはんだ接合部のひずみ挙動の可視化」<br>株式会社東芝<br>佐藤克哉<br>8B1-5（0028）                      | 「陰極上に機能性層を有するマイクロ流体有機EL素子の試作」<br>法政大学<br>三井俊希<br>8C1-6（0002）                            | 「固溶元素を添加したSn-Ag-Cu合金のクリープおよび熱疲労寿命におよぼす変形機構の影響」<br>芝浦工業大学大学院<br>恩田真<br>8D1-6（0023）                                                                                |
| 11:50<br>～<br>12:50 | 昼食、企業展示(60分)                                                                                 |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| セッション               | 先端プロセス・実装技術-1                                                                                | パワーエレクトロニクス実装技術-2                                                                   | エマージングテクノロジー                                                                            | 信頼性技術-2                                                                                                                                                          |
| 12:50               | 【依頼】<br>「CMOSイメージセンサを支える3D積層プロセス技術」<br>ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社<br>岩元勇人<br><br>8A2-1           | 「パワー半導体高温動作実装構造の信頼性」<br>大同大学<br>山田靖<br>8B2-1（0029）                                  | 「圧縮または引張り方向の合掌曲げによる有機エレクトロニクス用印刷Ag配線の疲労評価」<br>鹿児島大学<br>折尾五郎<br>8C2-1（0007）              | 「車載用BGA（Ball Grid Array）半導体パッケージはんだ接合部の熱疲労駆動力におよぼす構造因子解析」<br>芝浦工業大学大学院<br>水野聖哉<br>8D2-1（0024）                                                                    |
| 13:10               |                                                                                              | 「チップと基板の固相拡散接合における低加圧プロセスの適用検討」<br>三菱電機株式会社<br>山崎 浩次<br>8B2-2（0052）                 | 「ペンタセンを用いた有機薄膜トランジスタの合掌曲げ疲労評価」<br>鹿児島大学<br>福田将平<br>8C2-2（0008）                          | 「組織粗大化効果を組み込んだクリープ構成式を用いたBGA（Ball Grid Array）はんだ接合部の熱疲労解析におけるサイクルジャンプ法の検討」<br>芝浦工業大学大学院<br>亀倉遼太<br>8D2-2（0025）                                                   |
| 13:30               | 「ポリマー/銅ハイブリッド接合におけるウエハ接合強度測定」<br>横浜国立大学<br>近藤悠介<br>8A2-2（0037）                               | 「パワー半導体向け銅接合材の低加圧接合」<br>石原ケミカル株式会社<br>濱西恭良<br>8B2-3（0035）                           | 「TLMによる曲げ負荷下での有機薄膜トランジスタの電気特性変動における接触抵抗の影響評価」<br>鹿児島大学<br>井上将太郎<br>8C2-3（0015）          | 「Siダイ / アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度におよぼす球状シリカフィラー添加量の影響」<br>芝浦工業大学大学院<br>田中宏樹<br>8D2-3（0026）                                                                              |
| 13:50               | 休憩(20分)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 14:10               | 「プラズマ表面改質処理されたポリイミド保護膜の保管温度が封止樹脂との密着性に与える影響」<br>西日本工業大学<br>ハン セイナン<br>8A2-3（0045）            | 「青色半導体レーザを用いた純銅リボンはんだ付プロセスの短時間化」<br>大阪大学大学院<br>貴田優希<br>8B2-4（0046）                  | 「Sn-In／ZrO <sub>2</sub> ナノ粒子複合金合金におけるナノ粒子表面の分散性への影響」<br>大阪大学大学院<br>新田隼也<br>8C2-4（0009）  | 「高速温度サイクル試験によるパワー半導体デバイスAIワイヤボンド部の疲労き裂進展評価」<br>芝浦工業大学大学院<br>渡辺岬<br>8D2-4（0054）                                                                                   |
| 14:30               | 「裏面埋設・電源供給配線網を有する3次元集積回路の作製プロセス」<br>国立研究開発法人産業技術総合研究所<br>渡辺直也<br>8A2-4（0033）                 | 「Ar-FAB照射による異種基材の熱圧着」<br>Meisei University<br>Nora Martinez<br>8B2-5（0055）          | 「Sn-Bi二元系合金の合金組織および機械的特性に及ぼす室温エージングの影響」<br>株式会社日本スベリア社<br>赤岩徹哉<br>8C2-5（0073）           | 「An abnormal phenomenon observed for copper/epoxy bonding after 85°C/85% relative humidity test and its possible mechanism」<br>大阪大学 Shuaijie Zhao<br>8D2-5（0021） |
| 14:50               | 「銀シードめっき法を用いた高速リジッド基板」<br>DIC株式会社<br>田村礼<br>8A2-5（0036）                                      | 「赤外線画像によるフローはんだ付けプロセスにおける溶融はんだ噴流状態の把握」<br>三菱電機株式会社<br>瀧田若輝<br>8B2-6（0067）           | 「シリコン微細加工技術によるORC発電機の小型化」<br>日本大学<br>仁木雄哉<br>8C2-6（0057）                                | 「SiC-MOSFETのパワーサイクル試験におけるジャンクション温度モニタリングの課題」<br>産業技術総合研究所<br>加藤史樹<br>8D2-6（0071）                                                                                 |
| 15:10               | 休憩(20分)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| セッション               | 先端プロセス・実装技術-2                                                                                | パワーエレクトロニクス実装技術-3                                                                   | 最先端材料                                                                                   | 光回路実装技術                                                                                                                                                          |
| 15:30               | 【依頼】<br>「半導体分野における人材育成の現状と課題 シリコンアイランド再構築に向けて」<br>熊本大学<br>青柳昌宏<br><br>8A3-1                  | 【依頼】<br>「高温・高電流密度下のはんだ接合部における物質移動現象」<br>中京大学<br>山中公博<br><br>8B3-1                   | 「公開データに基づいたマテリアルズ・インフォマティクスと分子シミュレーションによる 界面強度向上設計」<br>株式会社日立製作所<br>岩崎富士<br>8C3-1（0003） | 「Co-Packaged Opticsに向けた薄膜チップ転写技術の開発」<br>東レエンジニアリング株式会社<br>風間浩一<br>8D3-1（0074）                                                                                    |
| 15:50               |                                                                                              |                                                                                     | 「銀系導電性接着剤の金属電極に対する界面組織および接着界面特性の変化に及ぼす化学的因子の影響」<br>群馬大学大学院<br>福島孝典<br>8C3-2（0027）       | 【依頼】<br>「データセンタ向け超高速EMLサブアセンブリ」<br>三菱電機株式会社<br>大晶伸夫<br><br>8D3-2                                                                                                 |
| 16:10               |                                                                                              |                                                                                     | 「三次元半導体集積回路のハイブリッド接合に向けた選択的レーザ加熱」<br>大阪大学大学院<br>浅原颯海<br>8A3-2（0060）                     |                                                                                                                                                                  |
| 16:30               | 休憩(20分)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 16:50               | 「UV処理したエポキシ系樹脂の表面官能基評価と異種界面の密着性」<br>大阪公立大学大学院<br>白樫陽菜<br>8A3-3（0061）                         | 「200℃におけるCu/Ni-P/Sn-5Sb-0.7Cuはんだ接合部エレクトロマイグレーション」<br>中京大学<br>小黒航平<br>8B3-3（0038）    | 「低温焼成用結晶制御銅微粒子系」<br>北海道大学大学院<br>米澤徹<br>8C3-4（0031）                                      | 【依頼】<br>「超小型VCSELトランシーバを用いたCo-Packaged Optics」<br>古河電気工業株式会社<br>長島和哉<br><br>8D3-3<br><br>17:20-----<br><br>【依頼】<br>「光コネクタ技術の最新動向」<br>千葉工業大学<br>長瀬亮<br><br>8D3-4  |
| 17:10               | 「複数回リフロー工程に適した高耐熱多層バリア電極の開発」<br>京セラ株式会社<br>前田和孝<br>8A3-4（0014）                               | 「パワーモジュールにおけるCu/Sn-5Sb/Ni-P/Al はんだ接合部のエレクトロマイグレーション」<br>中京大学<br>小西竣也<br>8B3-4（0039） | 「銅系導電性ペーストと銅電極界面の界面電気抵抗に及ぼす界面化学因子の効果」<br>群馬大学大学院<br>小田島大輔<br>8C3-5（0079）                |                                                                                                                                                                  |
| 17:30               | 「ナノボラスCuを用いた次世代接合技術の開発」<br>三菱マテリアル株式会社<br>森優太郎<br>8A3-5（0018）                                | 「パワー半導体実装用接合材料の高温・高電流密度での信頼性評価」<br>大同大学<br>松永いずみ<br>8B3-5（0032）                     | 「フィラー酸化を利用した銅系導電性ペーストの電気的信頼性向上のための界面化学設計」<br>群馬大学大学院<br>松浪由香里<br>8C3-6（0080）            |                                                                                                                                                                  |
| 17:50               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                  |